

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

## 有研粉末新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表（2024年5月29日）

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	华夏久盈保险资产、国新投资、国泰基金、金元顺安基金、华夏未来资本、国盛证券、长盛基金侯智中、真滢投资、新沃基金、天安财险、泉果基金、中信资管、太平洋资管、人保资产、红土创新、铜冠投资、招商证券、北信瑞丰基金、禾永投资、嘉合基金、光大保德信基金、上银基金、东兴基金、方正富邦、东吴基金、华夏基金、汇丰晋信、太平基金、申万菱信、泰康基金、国富人寿、长江养老、华安合鑫、正圆投资、杉树资产、合远投资、和聚投资、中邮理财、民生理财、长江资管、华创证券、红杉资本、中信保诚保险、中意资产	
会议时间	2024年5月29日 13:30-14:30 2024年5月29日 15:00-16:00	
会议地点	公司会议室	
上市公司接待人员	董事会秘书、财务总监、总法律顾问：姜珊 副总经理：刘祥庆 证券事务代表：王妍	
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：请介绍一下公司铜粉新产品开发情况。 A1：铜基板块目前实现突破的新产品主要为导热铜粉，主要用于制造风冷散热组件，与传统雾化铜粉相比，具有梯	

度孔隙结构、比表面积发达、松装密度低等特点。现已成功应用于部分散热器件，如VC板。该产品是公司与某终端用户合作开发的产品，据了解该产品目前已经部分应用于AI算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果截至目前反馈良好。此款铜粉在散热效率方面较传统雾化铜粉，性能提升10%-20%，热端收益3-5℃，属于行业内比较大的进步。目前实现每月小批量吨级销售，未来是否能进一步拓展应用领域，如传统热管等，尚有待市场进一步验证。

Q2: GPU客户进展、单位用量如何？未来对公司收入体量有何影响？

A2: 公司产品为导热铜粉，可以应用于散热器件，但不同场景使用的散热器件结构不一样，用量不同。普通平板结构VC的铜粉用量约100克/件。公司目前实现了吨级批量销售。未来预计会有一定的增长，但短期内对公司整体营收影响有限。

Q3: 公司对于应用领域的拓展有哪些困难？

A3: 导热铜粉应用的是一种新的产品结构，价格高于传统产品价格，下游产品的研发设计人员在选择应用时会考虑成本因素，以及与新产品的性能契合度。但目前一些散热组件厂商已经完成对公司该产品的热性能测试等基础工作，未来可能在合适的时机会逐步推广。

Q4: 公司四五月的经营情况如何？

A4: 公司经营业绩目前比较平稳，具体数据需要等到半年报公布。整体月均产销量约3000吨，营业收入约2.7亿/月。

Q5: 铜价上涨对公司毛利率有什么影响？

A5: 公司铜基、锡基板块定价模式主要为原材料加工费，原材料价格上涨会造成收入上升，加工费不变的情况下会降低毛利率。

Q6: 公司新产品价格目前比较高，未来是否有下降空间？

A6: 公司对新产品投入了较高的研发费用和较长的研发周期，目前国内外并没有同类产品，所以相对传统产品价格较高。随着产品应用领域的拓展、销售数量的增长，公司会考虑降低单位产品的价格。

Q7: 公司新产品的技术路径如何？

A7: 公司研发出了新的生产方法，改变了粉末的微观结

	<p>构，使产品具有梯度孔隙，在烧结成毛细芯后吸水速度高于传统雾化铜粉，带来了散热效率的提升。</p> <p>Q8：公司新产品和传统散热铜粉材料有区别吗？ A8：材质没有区别，只是加工方式不同。</p> <p>Q9：公司改变加工方式难度较大，为何会想到用新的方式生产？ A9：公司经过多年发展，在长期研发积累的大量实验数据、工艺经验基础上，形成了完善的研发技术体系，拥有国家级创新平台，材料研发团队可以参与到客户的设计端，共同设计、开发需要的粉体材料，定制适合于下游客户应用的粉体产品。本次新产品研发就起源于下游客户的应用需求，公司与下游产品研发设计人员一起设计开发，在加工方式上实现了突破，解决了以该方式制造的导热铜粉在产品应用上的问题，在行业内属于首创。</p> <p>Q10：3D 打印粉体材料销量如何？ A10：3D 打印粉体材料在正常推进，除了 JG 客户，民品上的应用公司也在积极推广。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 30 日</p>